证券代码：688693　　证券简称：锴威特　　公告编号：2026-051

苏州锴威特半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买晶艺半导体有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 8 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕42 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等文件。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日